



한국IR협회의

기업리서치센터 기업분석 | 2026.10.20

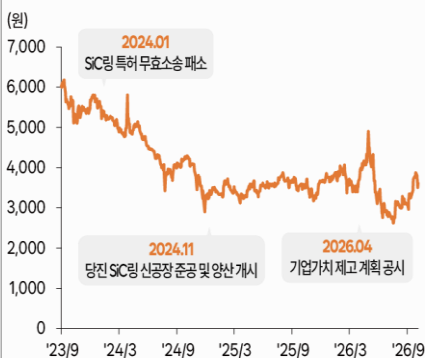
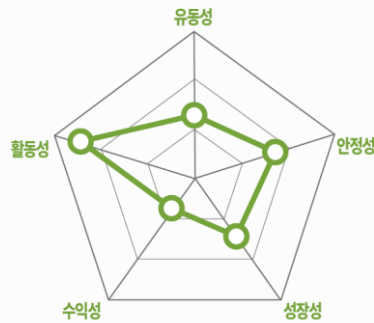
KOSDAQ | 디스플레이

와이엠씨 (155650)**반도체로 넓히는 성장, 주주환원으로 높이는 가치****기업가치 제고 계획 및 이행상황**

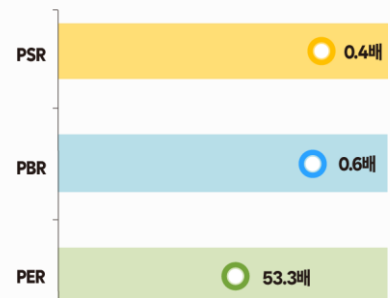
- 2026년 9월 기업가치 제고 계획 발표를 통해 자기주식 소각 및 배당 확대 중심의 중장기 주주환원 정책 강화. 반도체 SiC 링 신규 제조 확대에 따른 실적 성장과 주주환원 강화를 병행해 기업가치 제고 추진
- 2026년 3월 자기주식 50만주 소각 완료. 추가로 보유 자기주식 126만주 중 50% 이상인 약 63만주를 연내 소각 계획. 이행 시 발행주식총 수는 1,897만주에서 약 1,834만주로 감소하며, 기존 대비 3.32% 이상 추가 축소 전망
- 2026~2028년 매년 최소 50억원, 3년간 누적 150억원 이상 현금배당 목표 제시.
이는 2025년 배당총액 약 13억원 대비 연간 배당 규모가 약 3.8배 확대되는 수준.
최소 배당성장 30% 이상을 지향하며, 주주환원의 예측 가능성 및 배당 매력도 제고 기대

**체크포인트**

- 당진 신공장 양산에 따른 SiC 링 신규 제조 확대. 생산라인 가동률 상승 및 비포마켓 점유율 확대 여부 확인 필요
- 미국 글로벌 반도체 장비사향 공급 품목 3종에서 11종으로 확대. 고객사 평가 이후 정규 발주 확대가 기대됨
- 2026년 매출액 1,965억원(+13.8% YoY), 영업이익 72억원(+57.2%) 추정. 반도체 부품 성장과 판관비 부담 완화에 따른 수익성 개선 전망

주가 및 주요이벤트**재무지표**

주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표

주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

SiC 링 신규 제조 및 글로벌 고객 확대로 반도체 사업 성장 기대

자회사 와이컴은 2025년 당진 신공장 양산 개시로 기존 SiC 링 재생에서 신규 제조로 사업영역 확대. 2026년 상반기 와이컴 매출액은 175억원(+16.1% YoY) 기록. 한편 와이엠씨 본사는 미국 글로벌 반도체 장비사향 공급 품목을 3종에서 11종으로 확대하며 신규 성장 기반 확보. 신공장 가동을 상승과 글로벌 고객사 정규 발주 확대에 따른 반도체 사업 성장 기대.

자기주식 소각 및 배당 확대를 통한 주주가치 제고

2026년 9월 기업가치 제고 계획 발표를 통해 중장기 주주환원 정책 강화. 3월 자기주식 50만주 소각에 이어 연내 63만주 이상 추가 소각 계획으로 발행주식총수 3.32% 이상 추가 감소 전망. 2026~2028년 매년 최소 50억원, 누적 150억원 이상 배당 목표 제시. 2025년 대비 연간 배당 규모 약 3.8배 확대 및 배당 예측 가능성 제고 기대.

2026년 외형 성장과 수익성 개선 동반 전망

2026년 연결 매출액 1,965억원(+13.8% YoY), 영업이익 72억원(+57.2%), 영업이익률 3.7%(+1.1%p) 추정. 상반기 디스플레이 소재 매출 확대와 반도체 신공장 양산 효과로 실적 개선 확인. 하반기에는 상반기 대비 다소 둔화된 실적을 예상하나, 신규 제조 매출 확대와 판관비 부담 완화에 따른 연간 이익 성장 전망. 향후 신공장 가동을 상승과 글로벌 고객사 공급 확대가 주가 성장의 주요 변수.

Forecast earnings & Valuation

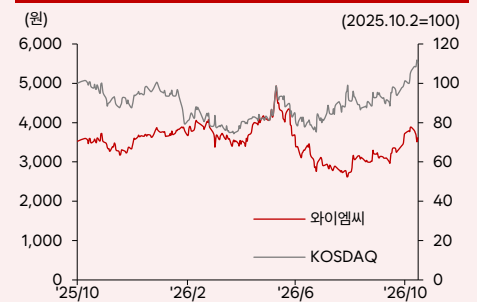
	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	2,354	2,046	1,677	1,728	1,965
YoY(%)	31.4	-13.1	-18.0	3.0	13.8
영업이익(억원)	231	158	69	46	72
OP 마진(%)	9.8	7.7	4.1	2.6	3.7
지배주주순이익(억원)	194	137	68	13	52
EPS(원)	969	702	347	68	271
YoY(%)	84.6	-27.6	-50.6	-80.4	299.3
PER(배)	5.8	8.1	9.6	56.3	13.3
PSR(배)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA(배)	2.7	4.6	5.4	6.3	4.8
PBR(배)	1.0	1.0	0.6	0.7	0.6
ROE(%)	19.3	12.4	5.9	1.2	4.5
배당수익률(%)	4.4	3.5	2.2	2.0	7.7

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (10/16)	3615원
52주 최고가	4,905원
52주 최저가	2,625원
KOSDAQ (10/16)	794.78p
자본금	100억원
시가총액	686억원
액면가	500원
발행주식수	19백만주
일평균 거래량 (60일)	5만주
일평균 거래액 (60일)	2억원
외국인지분율	4.43%
주요주주	이윤용 외 2인 3364%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	12.8	-8.9	0.7
상대주가	15.8	33.2	9.6

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶기업 밸류업 공식 법안 주주가치 존중 기업문화로의 변화를 위해 자발적으로 기업가치 제고 노력을 하는 기업. 기업가치 제고 계획을 자율적으로 수립하고, 이행하며 투자자와 소통하는 기업



기업 개요

기업개요 및 연혁

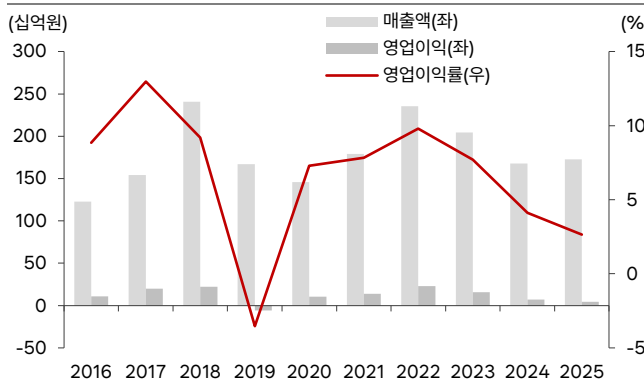
디스플레이 소재 국산화로 출발해 반도체 부품까지 사업 확장

와이엠씨는 디스플레이 및 반도체 제조공정에 사용되는 소재와 공정 부품을 생산하는 기업이다. 이윤용 대표이사는 서강대학교에서 경영학을 전공하고 삼성전자를 거쳐 2008년 2월 와이엠씨를 설립했다. 설립 초기에는 디스플레이 증착(Sputtering) 공정의 배선재료 쓰이는 Metal Target을 주요 제품으로 개발했으며, 2009년 삼성 협력업체로 등록됐다. 같은 해 삼성전자와 구매조건부 협약을 맺고 7세대 이상 대면적 Backing Plate 개발에 착수했다. 당시 대부분 일본산이었으나, 와이엠씨가 국산화에 성공했다. 이러한 기술력을 바탕으로 와이엠씨는 2012년 11월 코스닥에 상장했다.

2016년부터는 디스플레이 제조설비 이설 사업으로 외형을 빠르게 키웠다. 2017년 4월에는 SiC Ring 재생 기업 와이컴의 지분을 인수해 반도체 부품 사업에 진출했고, 2020년 4월에는 디스플레이 설비 유지보수(PM)를 담당하는 와이엠에스를 편입했다. 2024년 11월 와이컴 당진 공장을 설치하며 SiC 부품 재생에서 신규 제작으로 사업 영역을 확장하고 있다.

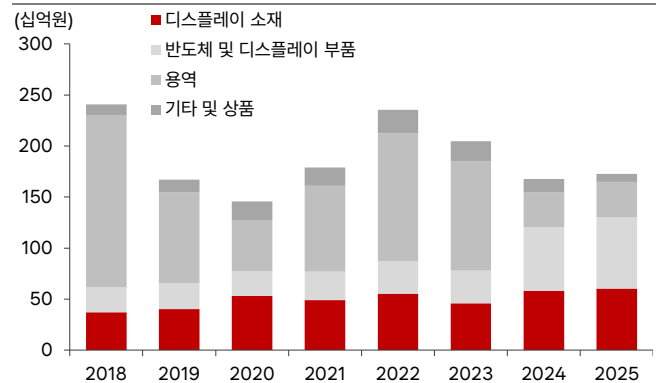
와이엠씨는 2025년 연결 매출액 1,728억원(YoY +3.0%), 영업이익 46억원(YoY -33.7%)을 기록했다. 주요 제품별 매출액은 반도체 및 디스플레이 부품 697억원(매출 비중: 40.3%), 디스플레이 소재 602억원(34.8%), 용역 351억원(20.3%), 기타 및 상품 78억원(4.5%)으로 구성된다.

매출액, 영업이익 및 영업이익률 추이



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

주요 제품별 매출액 추이

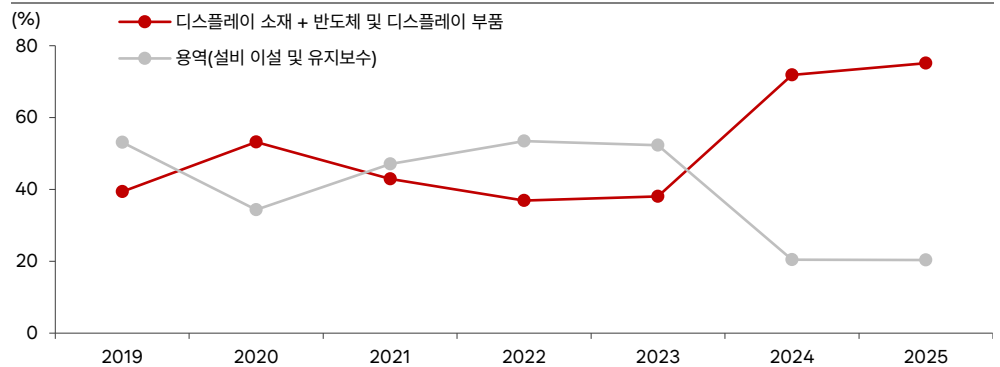


자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

와이엠씨의 외형 성장을 이끌었던 디스플레이 제조설비 이설 사업은 삼성디스플레이의 LCD 라인 이설 수주가 완료되면서 사실상 마무리됐다. 이설 매출이 포함된 용역 매출액은 2018년 1,683억원으로 전사 매출의 69.9%를 차지했고, 2022년에도 1,258억원(53.4%)에 달했다. 그러나 이설 종료 후 2024년에는 343억원으로 급감했으며, 현재 용역 매출은 삼성디스플레이향 설비 PM이 중심이다. 이에 따라 연결 매출액도 2018년 2,409억원을 고점으로 2024년 1,677억원까지 감소했다.

반면 디스플레이 소재와 반도체 및 디스플레이 부품을 합한 매출액은 2022년 869억원에서 2025년 1,299억원으로 증가했고, 매출 비중은 36.9%에서 75.2%로 높아졌다. 특히 반도체 및 디스플레이 부품 매출액은 OLED 라인항 공정 부품 공급 확대와 반도체 부품 사업 성장에 힘입어 같은 기간 315억원에서 697억원으로 2배 이상 늘었다. 와이엠씨는 일회성 이설 매출에 의존하던 구조에서 벗어나, 고객사 가동률에 따라 반복 수요가 발생하는 소재·부품 중심으로 사업구조를 재편하고 있다.

소재&부품, 용역 비중 추이



자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

주요 연혁

2008~2011 설립기(기술개발 및 사업 인프라 구축)	2012~2017 성장기(사업 확장 및 수익기반 강화)	2018~ 도약기(사업 경쟁력 강화 및 지속성장)
2008 와이엠씨(주) 설립 2009 S사 협력업체 등록 ISO 9001/14001 인증 2010 본사 사옥 신축(아산시 둔포면 테크노밸리) 와이엠씨(주) 기업부설연구소 2011 1천만불 수출의 탑 수상 유망중소기업 선정	2012 코스닥 상장 부품, 소재전문기업 인증(자식경제부) 2013 충청남도고용창출 우수기업 선정 중기청 고용 우수기업 선정 2014 모범납세자 표창(기획재정부장관) 2015 연결기준매출 500억 달성 2016 중소기업융합대전 대통령 표창 충청남도고용창출 우수기업 선정 2017 7천만불 수출의 탑 수상 반도체 SiC 양산 시작 와이컴 자회사 편입	2018 연결 매출액 2,400억 달성 2019 S사 우수 협력업체 선정 2020 와이엠에스(구, 레오텍) 자회사 편입 2022 2022년 일자리창출 유공 산업포장(고용노동부) 2023 대한민국 일자리 으뜸기업 인증서 2024 판교 신사옥 준공 2025 YMS 설립 및 PM사업 개시 2026 기업가치 제고 계획 발표

자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주구성 및 자회사

창업자 중심의 안정적인 지배구조

와이엠씨의 최대주주는 창업자인 이윤용 대표이사다. 2008년 회사 설립 이후 대표이사를 맡고 있으며, 최대주주 중심의 경영체제가 유지되고 있다. 2026년 6월 말 기준 발행주식수는 1,897만주이며, 이윤용 대표이사 개인 지분율은 33.51%, 특수관계인을 포함한 지분율은 33.64%다. 회사는 2026년 3월 자기주식 50만주를 소각했으며, 이윤용 대표와 박정근 임원은 6월 각각 3만주, 4천주를 추가 취득했다. 잔여 자기주식은 126만주(6.65%)다. 9월 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 연내 63만주 이상(발행주식총수의 약 3.3%)을 추가 소각할 계획이다.

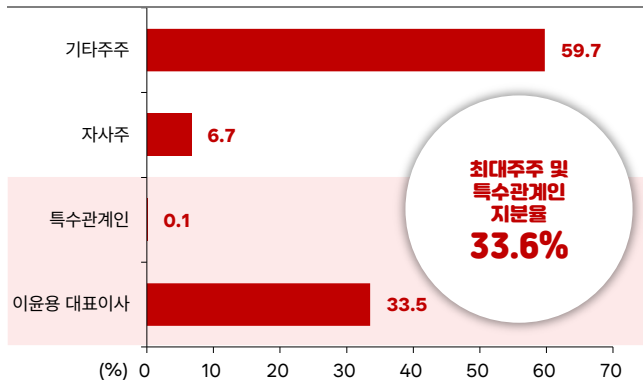
와이컴: SiC Ring 제조

와이엠에스: 디스플레이 설비 PM

2026년 6월 말 기준 연결 종속회사는 비상장사인 와이컴과 와이엠에스 2개사다. 와이컴은 2017년, 와이엠에스는 2020년 연결 자회사로 편입됐으며, 지분율은 각각 60.84%, 100%다. 와이컴은 반도체 식각공정에 사용되는 SiC Ring 제조 및 재생을 주력으로 한다. 기존 SiC 재생 기술을 기반으로 2024년 당진 공장을 구축해 Bulk SiC 생산능력을 확대했다. 와이엠에스는 삼성디스플레이 생산설비의 예방보전(PM) 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.

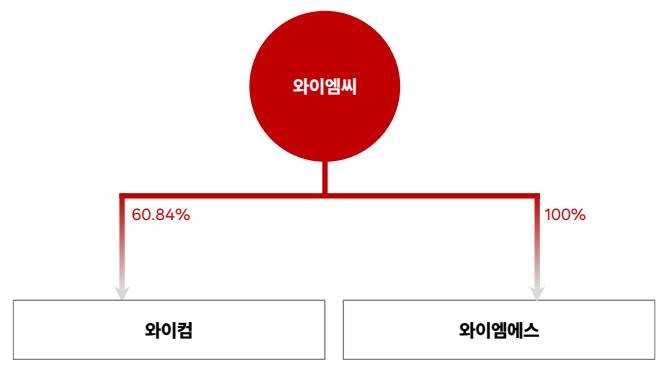
2026년 6월 말 기준 와이컴의 자산총액은 563억원, 와이엠에스는 113억원이다. 2026년 상반기 와이컴은 매출액 175억원, 순손실 6억원을 기록했으며, 와이엠에스는 매출액 176억원, 순이익 9억원을 기록했다. 와이컴의 적자가 지속되는 가운데 와이엠에스는 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다. 이 밖에 와이엠씨는 비상장사 위든의 지분 14.28%를 보유하고 있으며, 해당 기업은 지분법 적용 관계기업으로 분류된다.

주요 주주 및 지분율



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

2분기말 기준 지배구조도



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

사업부별 설명 및 주요 보유 기술

2025년 매출 비중:

디스플레이 소재 35%

반도체/디스플레이 부품 40%

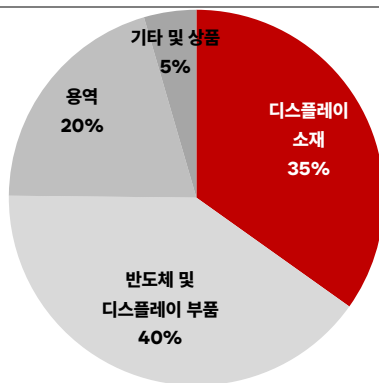
와이엠씨는 디스플레이용 소재 및 공정 부품을 주력으로 생산하는 기업으로, 반도체 식각공정용 SiC 부품과 디스플레이 설비 유지보수 사업을 함께 영위하고 있다. 사업은 디스플레이 소재, 반도체 및 디스플레이 부품, 용역, 기타 및 상품으로 구분된다.

2025년 연결 매출액 중 반도체 및 디스플레이 부품이 40.3%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 디스플레이 소재 34.8%, 용역 20.3%, 기타 및 상품 4.5% 순이었다. 2026년 상반기에는 디스플레이 소재 비중이 41.1%로 상승하며 최대 매출 사업으로 자리했다.

1) 디스플레이 소재 사업(35%)

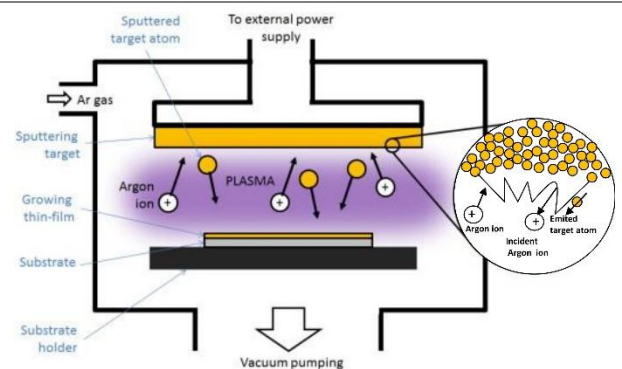
디스플레이 소재 사업은 스퍼터링 타겟(Sputtering Target)과 백킹플레이트(Backing Plate)를 주력으로 한다. 타겟은 디스플레이 패널에 전기신호를 전달하는 금속 배선과 전극을 만드는 데 사용되는 소재로, 알루미늄(Al), 구리(Cu), 티타늄(Ti), 몰리브덴(Mo) 등의 소재가 사용된다. 백킹플레이트는 타겟을 증착장비에 고정하고 열을 식히는 부품으로, 동사는 2009년 삼성전자와 협력해 대면적 백킹플레이트 개발에 착수한 이후 국산화에 성공했다. 타겟은 생산 과정에서 소모되기 때문에 패널 생산량이 증가할수록 교체 수요가 늘어난다. 반면 백킹플레이트는 교체주기가 약 8~9년으로 길어 신규 생산라인 투자와 노후 부품 교체가 주요 수요 요인이다. 이에 따라 디스플레이 생산라인 가동률과 신규 설비투자가 실적에 영향을 미친다.

2025년 사업부문별 매출액 비중



자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

스퍼터링(Sputtering): 디스플레이 유리기판 위 얇은 금속막을 만드는 공정



자료: Aissani et al.(2022), Coatings, 한국IR협회의 기업리서치센터

Sputtering 공정의 배선재로 사용되는 Target



자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

챔버 내 Target 장착 및 Cooling 역할의 Backing Plate



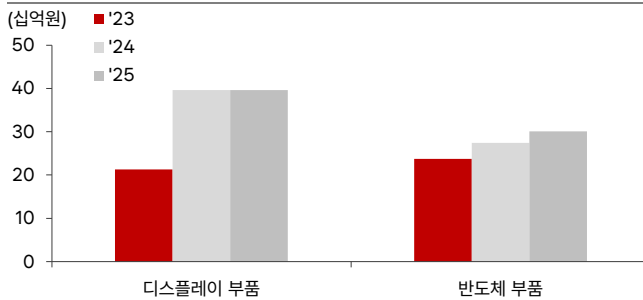
자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

2) 반도체 및 디스플레이 부품(40%)

반도체 및 디스플레이 부품 사업은 식각·증착공정에 사용되는 정밀 부품의 제조 및 재생을 담당한다. 주요 제품은 전극, 서셉터(Susceptor), 디퓨저(Diffuser) 등으로, 정밀가공 기술을 기반으로 신규 부품을 제작하고 사용한 부품은 세정·표면처리를 통해 재생한다. 아노다이징·용사코팅 등의 표면처리 기술은 부품의 내구성을 높이고 공정 중 이물질 발생을 줄이는 역할을 한다. 고객사의 생산설비 가동률과 부품 교체주기가 주요 매출 변수다.

반도체 부문은 자회사 와이컴을 중심으로 SiC(실리콘카바이드) 부품 사업을 확대하고 있다. SiC Ring은 반도체 식각공정에서 웨이퍼 주변의 플라즈마 분포를 안정적으로 유지하는 소모성 부품으로, 공정 미세화에 따라 높은 내구성과 정밀도가 요구된다. 와이컴은 사용한 SiC Ring의 마모된 부분에 SiC를 다시 증착하는 재생 기술을 확보하고 있으며, 2024년 250억원을 투자해 당진 공장을 구축하며 신규 제작으로 사업영역을 확장했다. 2025년 SiC Ring과 Cathode(캐소드) 신규 제품의 양산을 시작했으며, 회사는 2026년부터 관련 매출 기여 확대를 예상하고 있다.

반도체 및 디스플레이 부품 사업 매출액 추이



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

디스플레이 증착공정(CVD)에 사용되는 장비부품



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

산업 현황

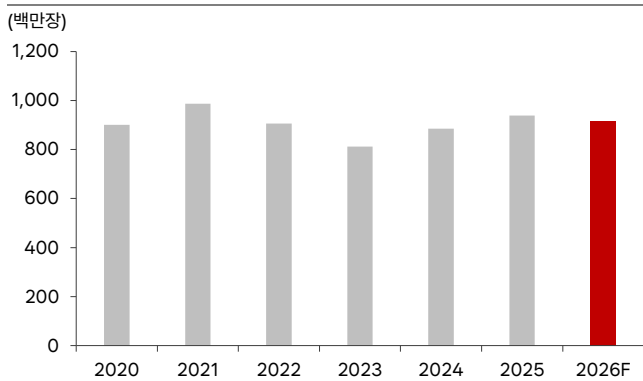
디스플레이: OLED 중심의 산업 재편과 설비투자 확대

디스플레이 산업은 IT용 OLED와
폴더블 OLED가 신규 수요를 형성

글로벌 디스플레이 산업은 LCD 중심의 성숙 시장에서 OLED 중심의 고부가 제품으로 전환되고 있다. 2026년에는 전방 IT 수요 둔화에도 노트북과 모니터용 OLED 시장의 성장세가 이어질 전망이다. 시장조사업체 Omdia는 2026년 글로벌 대형 디스플레이 출하량이 전년 대비 2.3% 감소하는 반면, 대형 OLED 출하량은 3,880만대(+18.8% YoY)를 기록할 것으로 전망했다. 특히 노트북용 OLED 출하량은 66.0%, 모니터용 OLED는 34.0% 증가할 것으로 예상했다. 전체 패널 수요보다 OLED 적용률 확대가 산업 성장의 주요 변수로 부상하고 있다.

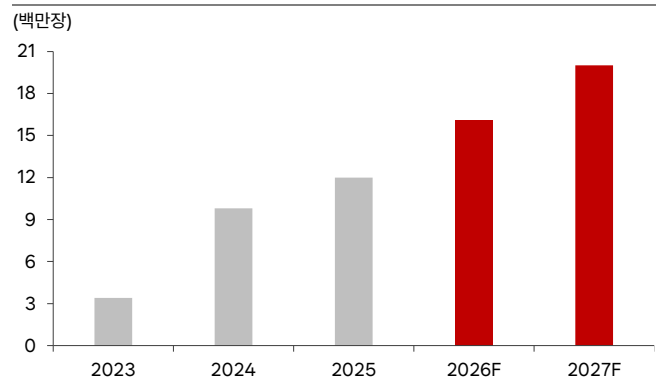
OLED 생산능력 확대를 위한 신규 설비투자도 진행되고 있다. 기존 6세대 라인 중심의 생산 체계에서 8.6세대 라인 생산체계로의 전환이다. 삼성디스플레이는 아산 A6에 8.6세대 IT OLED 생산라인을 구축했으며, 중국 BOE도 2026년 6월 청두 8.6세대 AMOLED 라인의 양산 개시를 발표했다. 기존 6세대 대비 대형 원장을 활용하는 8.6세대 생산라인은 노트북·태블릿 등 중형 OLED 패널의 생산 효율과 원가 경쟁력을 높이기 위한 투자다. 중장기적으로 OLED 적용 제품 확대와 생산라인의 고도화가 증착·식각 장비 및 관련 부품 수요를 뒷받침할 전망이다.

글로벌 대형 디스플레이 출하량



자료: Omdia, 한국IR협회의 기업리서치센터

노트북용 OLED 출하량 추이 및 전망



자료: Omdia, 한국IR협회의 기업리서치센터

주요 디스플레이 업체 8.6세대 OLED 투자 주요 타임라인

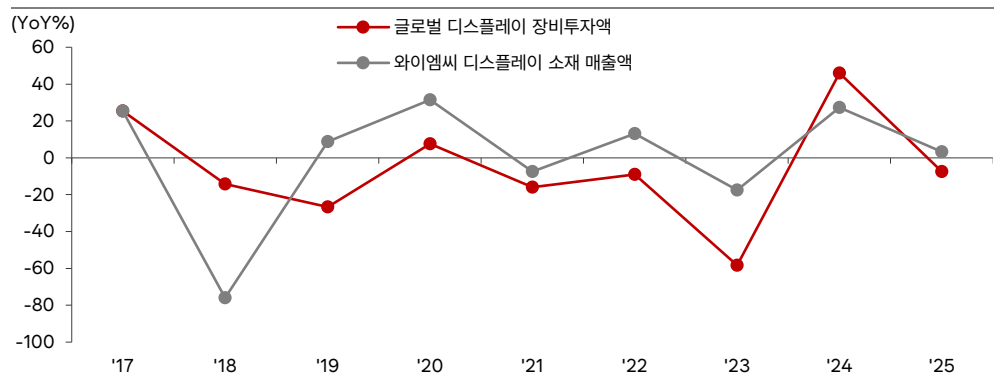
기업	투자 규모	설계 생산능력	초기 투입능력	투자 발표	장비 반입	라인 점등	샘플 출하	양산
삼성디스플레이	4.1조원	15000	7500	2023년 4월	2024년 3월	-	2026년 1월	2026년 7월
BOE	630 억위안	32000	16000	2023년 11월	2025년 5월	2025년 12월	-	2026년 6월
Visionox	550 억위안	32000	미확인	2024년 5월	2026년 4월	-	-	2027년(예정)
TCL CSOT	295 억위안	22500	미확인	2025년 9월	2026년 10월(계획)	-	-	2027년 4Q(예정)

자료: 전자신문, Counterpoint, 한국IR협회의 기업리서치센터

디스플레이 공정용 부품 시장은 신규 설비투자자와 기존 생산라인의 가동률에 따라 수요가 결정된다. 신규 라인 구축 시 전극, 서셉터, 디퓨저 등 장비 부품의 초도 수요가 발생하며, 양산 이후에는 플라스마에 노출된 부품의 마모와 오염으로 교체·재생 수요가 이어진다. 따라서 부품 신규 제작 매출은 고객사의 CAPEX에, 재생·세정 매출은 기존 설비의 가동률과 부품 교체주기에 상대적으로 민감하다. 와이엠씨는 정밀가공, 아노다이징, 용사코팅 및 세정 기술을 확보하고 있어 신규 투자뿐 아니라 기존 설비의 유지보수 수요에도 대응할 수 있는 사업구조를 갖추고 있다.

다만 OLED 산업 성장률이 동사의 매출 증가율로 직접 연결되는 것은 아니다. 신규 OLED 라인에서 동사 부품이 채택되는 범위와 고객사의 설비 발주 시점에 따라 실적 기여도가 달라질 수 있다. 특히 2026년 하반기 전체 디스플레이 수요가 둔화되는 가운데 OLED 투자와 실제 양산 가동률의 차별화가 예상된다. 따라서 디스플레이 부문은 신규 설비 투자 확대 여부와 함께 고객사의 OLED 생산라인 가동률, 부품 재생 물량 증가가 주요 변수로 판단한다.

글로벌 디스플레이 장비투자액과 와이엠씨 디스플레이 소재 매출 추이



자료: DSSC, 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

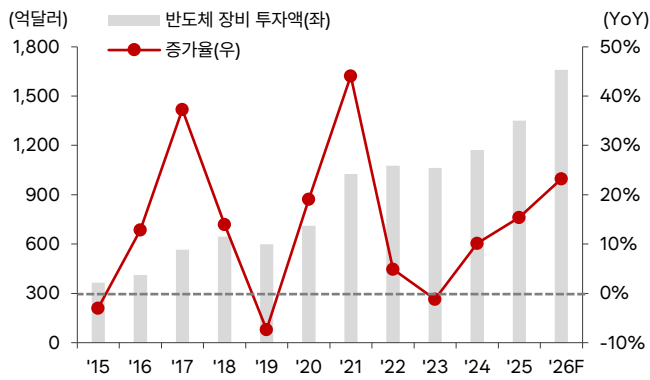
반도체: 설비투자 확대와 SiC 부품 수요 증가

반도체 생산능력 확대와 공정 고도화로 식각 소모성 부품 수요 증가

반도체 산업은 AI 인프라 투자 확대를 중심으로 회복세를 넘어 본격적인 성장 국면에 진입하고 있다. AI 서버용 HBM과 고성능 DRAM, 고적층 NAND 및 첨단 로직 반도체 수요 증가가 설비투자를 견인하고 있다. SEMI에 따르면 2026년 글로벌 반도체 제조장비 시장은 1,659억달러(+23.2% YoY), 이 중 전공정 장비(WFE) 시장은 1,439억달러(+23.1%)로 성장할 전망이다. 실제 2Q26 글로벌 반도체 장비 매출은 405억달러(+23% YoY)를 기록했다. 반도체 생산능력 확대와 공정 고도화가 식각 장비 및 소모성 부품 수요 증가로 연결될 전망이다.

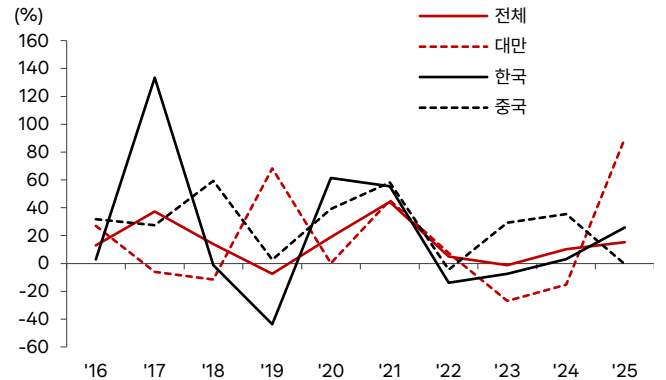
반도체 식각공정에 사용되는 SiC(Silicon Carbide) Ring은 플라스마 환경에서 웨이퍼 가장자리의 식각 균일성을 유지하는 소모성 부품이다. 고온과 플라스마에 대한 내성이 높아 반도체 미세공정에 사용되며, 일정 기간 사용한 이후 교체하거나 재생해야 한다. 특히 3D NAND의 적층 수 증가와 DRAM 및 로직 반도체의 미세화로 식각공정의 난이도가 높아지고 있다. Lam Research는 반도체 소자의 3차원 구조 전환에 따라 증착·식각 공정의 집약도가 약 2배로 증가할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 반도체 웨이퍼 생산량 증가뿐 아니라 웨이퍼당 식각공정 증가도 SiC 부품 수요를 뒷받침할 전망이다.

글로벌 반도체 장비 투자액 추이



자료: SEMI, 한국IR협회의 기업리서치센터

국가별 장비투자액 증가율



자료: SEMI, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 미세화고단화에 따른 SiC 링 수요 확대

반도체 고단화에 따른 SiC 수요 확대

SiC(Silicon Carbide, 탄화규소) 링은 반도체 건식 식각(Dry Etching) 장비에서 웨이퍼 주변에 설치되는 소모성 부품이다. 플라즈마 분포를 균일하게 유지해 식각 정밀도와 수율을 높이는 역할을 한다. 기존에는 실리콘(Si) 소재가 주로 사용됐으나, 반도체 미세화와 고집적화에 따라 내플라즈마성과 내구성이 우수한 SiC 링의 채택이 확대되고 있다. 특히 CVD(화학기상증착) 방식으로 제조한 고순도 SiC 링은 일반 Si 링보다 수명이 길고 공정 중 파티클 발생을 억제하는데 유리하다.

SiC 링 수요는 반도체 생산량과 식각 장비 가동률, 공정 복잡도에 영향을 받는다. DRAM 미세화와 3D NAND 고단화로 식각 단계가 증가하고, 고종횡비(High Aspect Ratio) 식각공정의 중요성이 높아지고 있다. 이에 따라 식각 장비당 SiC 부품의 사용량과 교체 수요가 확대될 가능성이 있다. 특히 신규 장비에 탑재되는 초도 부품뿐 아니라 기존 장비에서 주기적으로 교체하는 소모품 매출이 발생한다는 점에서, 반도체 설비투자자 실제 생산라인 가동률이 모두 중요한 수요 변수다.

신규 제조와 재생 시장의 경쟁구도

SiC 링 시장은 신규 부품 제조와 사용 후 부품을 재생하는 시장으로 구분된다. 신규 링은 반도체 장비 제조사에 공급하는 Before Market과 반도체 제조사에 직접 공급하는 After Market으로 나뉜다. 글로벌 시장에서는 티씨케이가 주요 공급업체로 자리 잡고 있으며, 국내에서는 케이엔제이, 하나머티리얼즈 등이 경쟁하고 있다. 신규 제품은 고순도 소재 제조와 정밀가공, 고객사 공정 인증이 필요해 진입장벽이 높다. 특히 식각 균일도와 파티클 발생이 반도체 수율에 영향을 미치는 만큼 기존 공급사의 제품을 교체하기 위해서는 충분한 품질 검증이 요구된다.

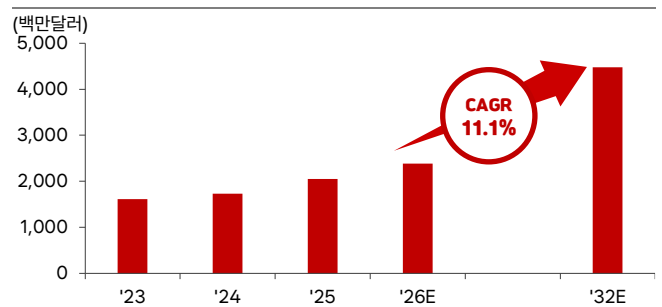
재생 시장은 마모된 SiC 링의 표면을 복원해 재사용하는 구조다. 신규 제품 구매 대비 비용을 절감하고 부품 사용 기간을 연장할 수 있다는 점에서 수요 확대 가능성이 있다. 와이엠씨는 자회사 와이컴을 통해 SiC 링 재생사업을 영위하고 있으며, 2024년 당진사업장에 Bulk SiC 제조시설을 구축해 신규 제품 생산으로 사업영역을 확대했다. 다만 재생 시장에서도 고순도 유지와 재생 후 수율 확보가 중요하며, 기존 제품의 특허와 공정기술이 경쟁력 및 원가구조에 영향을 미친다. 실제로 와이엠씨·와이컴은 2025년 7월 티씨케이와 특허분쟁을 합의로 종결했으며, 보도에 따르면 향후 관련 매출의 일정 부분을 특허료로 지급하기로 했다.

CVD SiC Ring



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 실리콘 부품 시장 규모 및 전망



자료: QYResearch(26.6), 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 식각공정(Etching)용 소모성부품 밸류체인



자료: 월덱스, 한국IR협회의 기업리서치센터



투자포인트

SiC 링 생산 확대에 따른 반도체 사업 성장 본격화

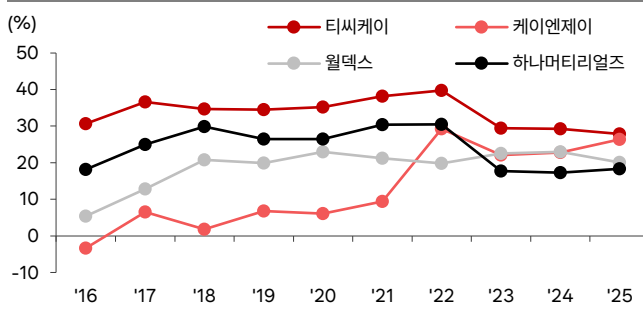
신공장 가동 효과 본격화

자회사 와이컴의 SiC 링 사업이 신규 생산능력 확대를 기반으로 본격적인 성장 국면에 진입할 전망이다. SiC 링은 반도체 식각공정에 사용되는 소모성 부품으로, AI 반도체 수요 증가와 3D NAND 고단화에 따른 식각공정 난이도 상승으로 고내구성 제품의 수요가 확대되고 있다. 글로벌 반도체 설비투자 재개와 공정 고도화에 따른 부품 교체 수요 증가도 성장에 긍정적이다.

와이컴은 기존 SiC 링 재생 중심에서 신규 제품 제조로 사업영역을 확대하고 있다. 2018년 독자적인 SiC 링 재생 기술을 인증받은 이후 재생사업을 주력으로 영위해 왔으며, 2025년 당진 신공장 가동을 통해 신규 제조 역량을 확보했다. 이에 따라 기존 재생사업의 안정적인 교체 수요에 신규 제품 매출이 더해지면서 외형 성장이 가속화될 전망이다. 특히 반도체 장비사에 공급되는 비포마켓은 엄격한 품질 인증과 장기간의 신뢰성 검증이 요구돼 진입장벽이 높고 수익성도 우수하다. 비포마켓 중심의 티씨케이와 하나머티리얼즈는 2023~2025년 평균 영업이익률이 각각 28.8%, 17.7%로, 양사 평균 23.3%를 기록했다. 와이컴 역시 신규 제조 역량을 기반으로 고부가 제품 비중을 확대하며 중장기적인 수익성 개선이 기대된다.

신공장 가동 효과는 2026년 실적에 반영되고 있다. 상반기 연결 매출액은 1,005억원(+19.2% YoY), 영업이익은 39억원(+55.3%)을 기록했으며, 2분기 영업이익률은 5.2%로 1분기 2.3% 대비 상승했다. 반도체 사업은 신규 생산라인 가동에 힘입어 높은 성장세를 기록했으며, 상반기 매출 규모도 디스플레이 사업 수준까지 확대됐다. 와이컴의 당진 신공장 양산 이전(1H24)과 양산 이후(1H26)를 비교하면, 와이컴의 1H26 매출액은 175억원으로 1H24 136억원대비 +32.4%의 매출액 성장을 보였다. 향후 당진 신공장 가동에 상승에 따른 고정비 부담 완화와 신규 제품 매출 확대가 외형 성장 및 수익성 개선을 동시에 견인할 전망이다.

주요 경쟁사 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

와이컴 기존 안성공장 vs 당진 신공장 비교

구분	기존 안성공장	당진 신공장
소재지	경기 안성시	충남 당진시
주요 사업	SiC 링 재생	Bulk SiC 링 신규 제조
생산방식	SiC Re-Growth	Bulk SiC 제조
완공일	2016년 2월	2024년 9월
양산 개시	2016년 4월	2025년 5월
최초 투자계획(억원)	미확인	355
대지면적(m ²)	6,000	24,000
건물면적(m ²)	1,950	4,300

자료: 언론종합, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 반도체 고객 확보에 따른 추가 성장 기대

글로벌 장비사향 공급 품목 확대

글로벌 반도체 장비사향 부품 공급이 신규 성장동력으로 부상하고 있다. 당사는 2026년 5월 미국 글로벌 반도체 장비 업체에 엣지링(Edge Ring)을 포함한 부품 3종의 초도 물량을 납품했으며, 고객사의 추가 요청으로 7월 공급 품목이 11종까지 확대됐다. 엣지링은 반도체 식각공정에서 웨이퍼 가장자리의 플라즈마 분포를 조절하고 식각 균일도를 높이는 부품이다. 글로벌 장비사향 공급 이력을 확보하고 단기간에 품목을 확대했다는 점에서 고객 다변화의 기반을 마련한 것으로 판단한다.

이번 거래는 자회사 와이컴의 SiC 링 제조·재생 사업과 별개로, 와이엠씨 본사가 직접 진행하는 반도체 장비 부품 공급 사업이다. 글로벌 장비사향 부품은 정밀 가공 기술과 품질 안정성이 요구되며, 고객사 검증을 거쳐 공급 이력을 확보해야 하는 만큼 신규 진입장벽이 존재한다. 향후 기존 고객사 내 공급 품목 확대와 추가 장비사 확보로 이어질 경우 반도체 사업의 외형 성장에 기여할 전망이다.

현재 미국 고객사 초도 납품 이후 추가 평가가 진행 중이며, 제품별 ASP와 수익성은 공개되지 않았다. 따라서 단기 실적 기여 규모를 구체화하기는 어려우나, 고객사 평가 완료와 정규 발주 확대가 이어질 경우 추가 매출 확보가 가능할 것으로 예상된다. 중장기적으로 글로벌 장비사 공급 이력 축적에 따른 고객 다변화와 반도체 부품 매출 비중 확대가 기업가치 재평가의 주요 변수로 작용할 전망이다.

자기주식 소각 및 배당 확대를 통한 주주가치 제고

배당 확대와 자사주 소각 병행

와이엠씨는 자기주식 소각과 배당 확대를 중심으로 주주환원 정책을 강화하고 있다. 동사는 2026년 3월 자기주식 50만주를 소각했으며, 9월 발표한 기업가치 제고 계획을 통해 보유 자기주식 126만주 중 50% 이상인 약 63만주를 연내 추가 소각할 계획이다. 계획대로 이행될 경우 발행주식총수는 추가로 3.32% 이상 감소할 전망이다.

배당 규모도 확대할 계획이다. 동사는 2026~2028년 매년 최소 50억원, 3년간 누적 150억원 이상을 배당하겠다는 목표를 제시했다. 이는 2025년 현금배당액 약 13억원 대비 연간 배당 규모가 약 3.8배 확대되는 수준이다. 이와 함께 최소 배당성향 30% 이상을 지향하고 있다. 현 주가 기준 배당수익률은 7.2%이다.

반도체 SiC 링 사업 확대에 따른 실적 성장과 주주환원 강화가 병행된다는 점에서 긍정적으로 판단한다. 자기주식 소각은 잠재적인 주식 공급 부담을 완화하고, 배당 확대는 주주환원의 예측 가능성을 높여 밸류에이션에 긍정적으로 작용할 수 있다. 다만 반도체 사업 확대에 따른 추가 투자 수요를 고려할 때 안정적인 현금흐름 확보와 주주환원 계획의 실제 이행 여부가 중요하다.

와이엠씨 자기주식 소각 현황 및 계획

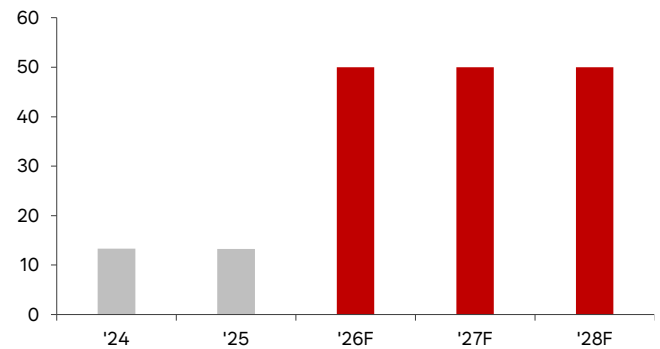
(단위: 만주)

	2025년 말	2026년 3월 소각 후	추가 소각 시
발행주식총수	1,947.4	1,897.4	1,834.4
자기주식 소각 수	-	50	631
보유 자기주식수	176.1	126.1	63.1
발행주식수 감소율	-	2.57%	3.32%
상태	소각 전	소각 완료	소각 계획

자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

와이엠씨 연간 현금배당 총액 추이 및 계획

(억원)



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1H26 Review

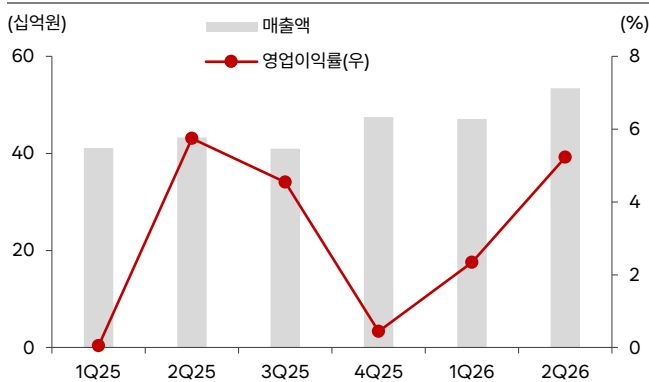
상반기 디스플레이 내수 매출 확대가 성장을 견인

2026년 상반기 연결 매출액은 1,005억원(+19.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 39억원(+55.3%)을 기록했으며, 영업이익률은 3.9%(+0.9%p)로 상승했다. 당기순이익은 39억원으로 전년 동기 1억원 미만에서 크게 증가했다.

외형 성장은 디스플레이 소재 내수 매출 확대와 반도체 신공장 양산에 기인한다. 상반기 디스플레이 소재 매출액은 413억원(+50.1%)으로 전체 매출의 41.1%를 차지했다. 상반기 디스플레이 소재 가동률도 전년 55%에서 81%로 상승했다. 반면 반도체 및 디스플레이 부품 매출액은 354억원(-2.0%), 용역 매출액은 180억원(+3.9%)을 기록했다.

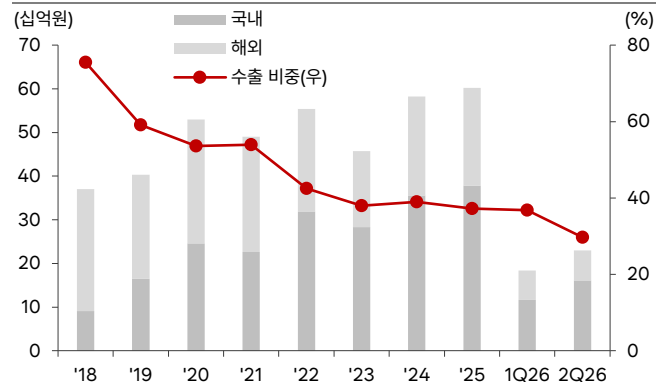
수익성 개선에는 매출 증가에 따른 판관비율 하락과 자회사 실적 회복이 기여했다. 자회사 와이컴은 당진 신공장 양산 확대에 따라 매출액 175억원(+16.1%)을 기록했으나, 순손실 6억원으로 적자가 지속됐다. 다만 이는 영업적자를 의미하지 않으며, 상반기 전환사채 관련 이자비용 14억원이 순이익에 부담으로 작용했다. 반면 와이엠에스는 매출액 176억원(+43.4%), 순이익 9억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자전환했다.

분기별 실적 추이 및 영업이익률



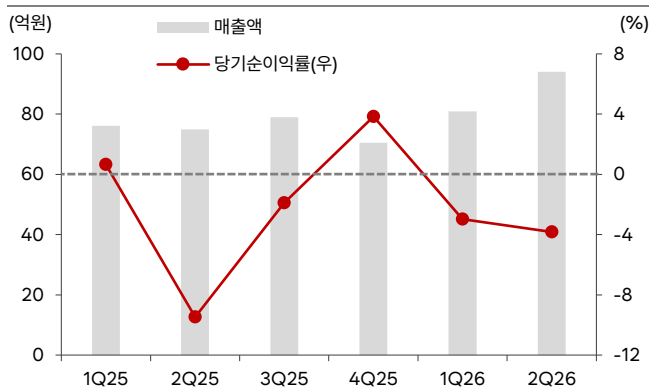
자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

디스플레이 소재 사업 지역별 매출액 - 내수가 견인하는 성장



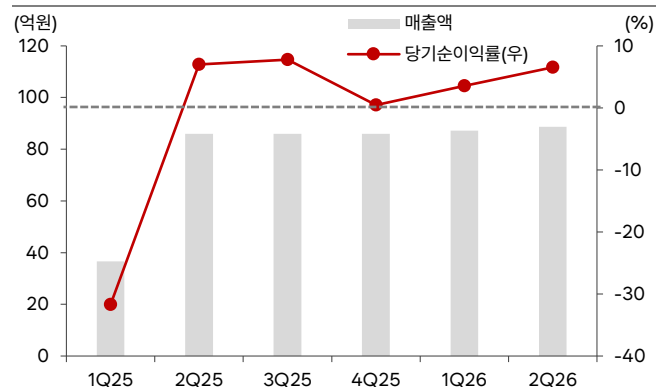
자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

와이컴 실적 추이



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

와이엠에스 실적 추이



자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

2026년 실적 전망

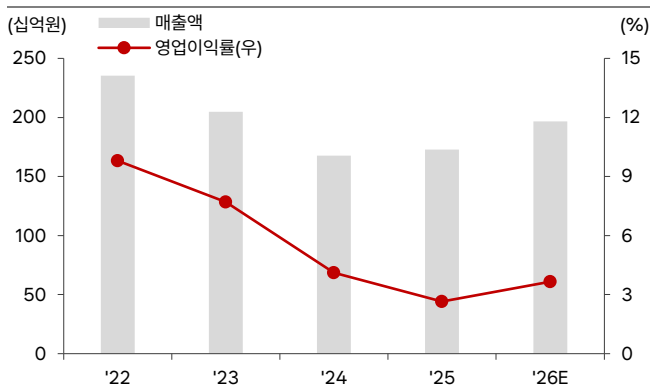
외형확대에 따른 수익성 개선

2026년 연결 매출액은 1,965억원(+13.8% YoY), 영업이익은 72억원(+57.2%), 영업이익률은 3.7%(+1.1%p)로 추정한다. EBITDA는 149억원(+16.5%), 당기순이익은 47억원(+322.0%)을 기록할 전망이다. 디스플레이 소재 사업이 외형 성장을 견인하는 가운데, 반도체 부품 사업에서도 신규 제조 확대에 따른 실적 기여 본격화가 예상된다.

외형 성장은 디스플레이 소재 사업이 주도할 전망이다. 글로벌 대형 디스플레이 시장은 패널 대형화에 따른 출하면적 증가가 예상되며, 주요 고객사향 소재 공급 확대가 매출 성장에 기여할 것으로 판단한다. 반도체 부품 사업에서도 유의미한 성장세가 나타날 전망이다. 자회사 와이컴은 당진 신공장을 기반으로 기존 SiC 링 재생에서 신규 제조로 사업 영역을 확대하고 있으며, 신규 생산능력의 매출 기여도가 점진적으로 높아질 전망이다.

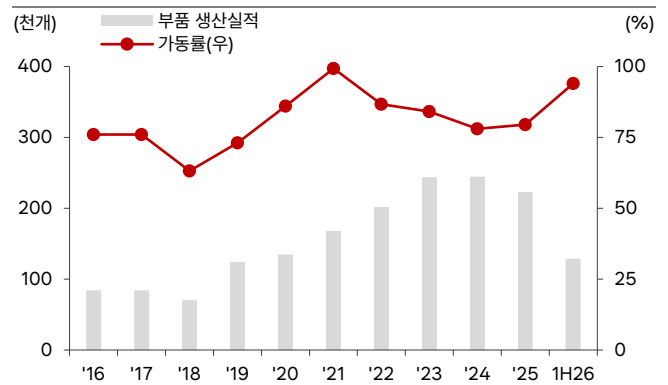
수익성 측면에서는 외형 성장에 따른 판관비 부담 완화가 예상된다. 매출총이익률은 12.5%(-0.1%p)로 전년과 유사한 수준이나, 판관비율은 2025년 9.9%에서 2026년 8.9%로 하락할 전망이다. 이에 따라 영업이익은 외형 성장률을 상회하는 증가세를 기록할 것으로 예상된다. 한편 미국 반도체 고객사향 신규 부품 공급 확대는 중장기 추가 성장 요인으로, 고객사 평가 완료 및 후속 수주 확보 여부가 향후 실적 성장의 주요 변수로 판단된다.

연도별 실적 추이 및 영업이익률



자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

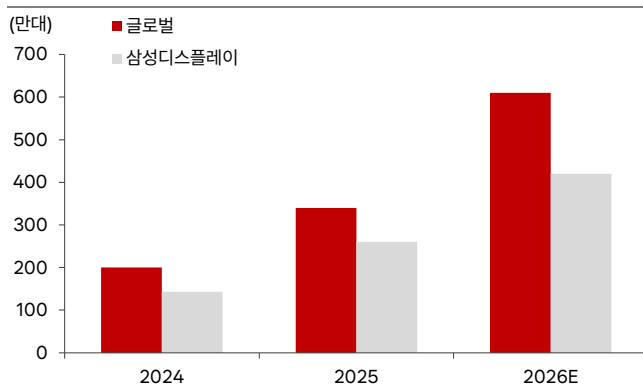
부품 사업 가동률 추이



주: 중국 자회사 실적은 제외, 2026년은 상반기 누적 기준

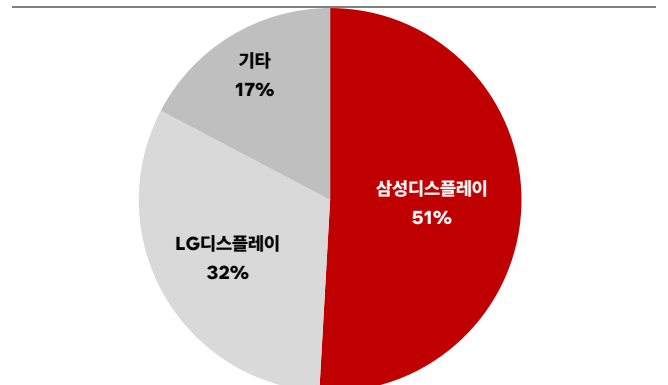
자료: 와이엠씨, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 및 삼성디스플레이 OLED 모니터 패널 출하량, 전망 및 목표치



자료: Omdia, 삼성디스플레이, 한국IR협회의 기업리서치센터

2025년 대형 OLED 패널 시장점유율



자료: Omdia, 한국IR협회의 기업리서치센터

와이엠씨 2026년 실적 추정					(단위: 억 원, %)
	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	2,354	2,046	1,677	1,728	1,965
디스플레이 소재	554	458	583	602	819
반도체 및 디스플레이 부품	315	321	622	697	773
기타	1,485	1,268	472	429	373
영업이익	231	158	69	46	72
영업이익률	9.8	7.7	4.1	2.6	3.7
당기순이익	194	137	68	13	52
당기순이익률	8.2	6.7	4.0	0.8	2.6
YoY					
매출액	31.4	-13.1	-18.0	3.0	13.8
디스플레이 소재	13.1	-17.4	27.4	3.3	36.1
반도체 및 디스플레이 부품	13.2	1.8	94.2	11.9	11.0
기타	45.2	-14.6	-62.8	-9.1	-13.0
영업이익	64.3	-31.7	-56.3	-33.7	57.2
당기순이익	84.6	-29.2	-50.7	-80.4	293.4

자료: 와이엠씨, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation
1 디스플레이 안정성 위에 반도체 성장성이 더해지는 구간
**디스플레이 기반 위에 반도체 성장
가시화**

와이엠씨의 현재 주가는 3,615원, 시가총액은 약 686억원으로 2026년 예상 실적 기준 P/E 13.3배, P/B 0.6배 수준이다. 국내외 반도체 부품 Peer 6개사의 2026F P/E 평균은 17.8배, P/B 평균은 2.8배로 동사는 상대적으로 낮은 밸류에이션을 적용받고 있다. 특히 P/B는 Peer 중 가장 낮은 수준이다. 다만 2026F ROE는 4.5%로 Peer 평균 16.3%를 크게 하회해 수익성 격차가 밸류에이션 할인 요인으로 작용하고 있다고 판단한다.

동사는 디스플레이 소재·부품 사업을 기반으로 안정적인 실적을 창출하는 가운데, 자회사 와이컴을 중심으로 반도체 부품 사업을 확대하고 있다. 현재 디스플레이 중심의 사업구조와 반도체 Peer 대비 낮은 수익성이 밸류에이션 할인 요인으로 판단되나, 향후 반도체 사업의 성장성이 부각되면서 재평가가 가능할 전망이다. 와이컴은 SiC 링 생산능력을 확대하고 있으며, 글로벌 반도체 고객사 확보도 추진하고 있다. 특히 진입장벽이 높은 비포마켓에서 신규 고객 확보와 공급물량 확대가 가시화될 경우 반도체 사업 비중 상승과 수익성 개선이 동시에 이루어질 것으로 기대된다.

적극적인 주주환원 정책도 기업가치 제고 요인이다. 동사는 2026~2028년 매년 최소 50억원, 3년간 총 150억원 이상의 현금배당을 계획하고 있다. 연간 배당금 50억원을 가정할 경우 현재 시총 대비 배당수익률은 7.2%에 달한다. 또한 2026년 중 보유 자기주식의 50% 이상을 추가 소각할 계획이다. 향후 반도체 사업의 이익 기여도 확대와 주주환원 계획의 이행이 밸류에이션 할인 축소의 주요 변수로 판단한다.

Global Peer Valuation

(단위: 십억원, 배, %)

	종가 (원, 달러, 엔)	시가 총액	매출액		영업이익		P/E		P/B		ROE	
			2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F
와이엠씨	3,615	69	173	197	5	7	56.3	13.3	0.7	0.6	1.2	4.5
케이엔제이	27,550	221	84	152	22	31	6.8	8.8	1.8	1.8	30.8	22.9
티씨케이	241,500	2,700	301	415	84	124	23.7	25.2	3.1	4.5	13.5	19.1
하나머티리얼즈	54,200	1,072	273	379	50	100	22.2	14.6	1.8	1.7	9.4	13.6
코미코	24,700	1,269	604	716	111	120	18.6	23.5	3.4	3.7	18.5	17.9
Ferrotec	9,150	4,207	2,734	2,891	272	323	22.8	18.4	1.1	1.8	6.0	8.7
Ultra Clean Holdings	51	3,100	2,921	3,651	-154	277	N/A	16.4	1.6	3.3	N/A	15.5

주: 주가는 10월 16일 종가 기준, 와이엠씨는 당사 추정치, 그 외 기업들은 시장 컨센서스 참고. Ferrotec은 일본, Ultra Clean Holdings는 미국에 본사를 둔 기업.

자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인
1 비포마켓 점유율 확대 지연 가능성
**신규 고객 확보 및 점유율 확대가
관건**

와이엠씨의 SiC 링 사업 확대 과정에서 비포마켓 진입장벽이 부담요인으로 작용할 수 있다. 비포마켓은 반도체 장비 제조사에 정품 부품을 공급하는 시장으로, 애프터마켓 대비 높은 수준의 품질 검증과 공급 안정성이 요구된다. 특히 티씨케이 등 기존 업체들이 글로벌 장비사와 장기간 공급관계를 구축하고 있어 신규 업체의 점유율 확대에는 상당한 시간이 소요될 수 있다.

동사는 2025년 당진 신공장 양산을 시작하며 SiC 링 신규 제조 역량을 확대했다. 또한 2026년 5월 미국 반도체 장비사에 부품 3종을 초도 납품한 이후 7월에는 공급 품목을 11종까지 확대했다. 다만 초도 납품과 공급 품목 확대가 안정적인 양산 물량 확보로 이어지는지는 추가 확인이 필요하다. 향후 신규 고객사 확보와 기존 고객사 내 공급 비중 확대가 지연될 경우 증설 설비의 가동률 상승이 제한되고, 고정비 부담으로 반도체 사업의 수익성 개선 속도도 둔화될 수 있다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	2,354	2,046	1,677	1,728	1,965
증가율(%)	31.4	-13.1	-18.0	3.0	13.8
매출원가	1,996	1,752	1,449	1,511	1,720
매출원가율(%)	84.8	85.6	86.4	87.4	87.5
매출총이익	358	294	228	217	246
매출이익률(%)	15.2	14.4	13.6	12.6	12.5
판매관리비	127	136	159	171	174
판매관리율(%)	5.4	6.6	9.5	9.9	8.9
EBITDA	279	209	130	128	149
EBITDA 이익률(%)	11.8	10.2	7.7	7.4	7.6
증가율(%)	44.6	-25.1	-37.9	-1.6	16.5
영업이익	231	158	69	46	72
영업이익률(%)	9.8	7.7	4.1	2.6	3.7
증가율(%)	64.3	-31.7	-56.3	-33.7	57.2
영업외손익	1	8	8	-36	-6
금융수익	20	30	58	31	46
금융비용	25	25	48	63	48
기타영업외손익	6	3	-3	-4	-4
종속/관계기업관련손익	0	-0	-0	-0	-0
세전계속사업이익	232	165	77	10	66
증가율(%)	49.1	-28.6	-53.4	-87.5	583.7
법인세비용	27	17	10	-2	19
계속사업이익	205	148	67	11	47
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	205	148	67	11	47
당기순이익률(%)	8.7	7.2	4.0	0.6	2.4
증가율(%)	73.4	-27.7	-54.8	-83.4	322.0
자배주주지분 순이익	194	137	68	13	52

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	232	192	114	42	33
당기순이익	205	148	67	11	47
유형자산 상각비	46	49	59	80	75
무형자산 상각비	2	2	2	2	2
외환손익	8	3	1	4	0
운전자본의감소(증가)	-37	-9	-14	-85	-78
기타	8	-1	-1	30	-13
투자활동으로인한현금흐름	1	-403	-77	-41	-42
투자자산의 감소(증가)	0	-1	0	0	-1
유형자산의 감소	0	52	1	3	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-119	-292	-215	-21	-10
기타	120	-162	137	-23	-31
재무활동으로인한현금흐름	-59	127	-59	23	-12
차입금의 증가(감소)	0	40	0	40	1
사채의증가(감소)	0	185	0	0	0
자본의 증가	0	3	0	0	0
배당금	-28	-46	-36	-13	-13
기타	-31	-55	-23	-4	0
기타현금흐름	-6	-2	4	-2	3
현금의증가(감소)	167	-87	-18	22	-19
기초현금	202	369	281	263	285
기말현금	369	281	263	285	266

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	820	826	676	811	951
현금성자산	369	281	263	285	266
단기투자자산	113	215	54	84	125
매출채권	98	96	116	163	158
재고자산	177	215	233	270	391
기타유동자산	64	18	11	9	10
비유동자산	601	864	1,045	984	918
유형자산	480	678	757	714	649
무형자산	45	44	50	50	48
투자자산	65	125	122	97	98
기타비유동자산	11	17	116	123	123
자산총계	1,421	1,690	1,722	1,794	1,869
유동부채	258	414	429	502	579
단기차입금	0	0	0	40	30
매입채무	64	105	94	90	149
기타유동부채	194	309	335	372	400
비유동부채	8	49	52	52	53
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	40	40	40	40
기타비유동부채	8	9	12	12	13
부채총계	266	463	481	554	631
자배주주지분	1,076	1,132	1,145	1,144	1,147
자본금	100	100	100	100	100
자본잉여금	193	193	193	193	193
자본조정 등	-83	-84	-102	-102	-102
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	866	923	954	954	956
자본총계	1,155	1,227	1,240	1,240	1,238

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	5.8	8.1	9.6	56.3	13.3
P/B(배)	1.0	1.0	0.6	0.7	0.6
P/S(배)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA(배)	2.7	4.6	5.4	6.3	4.8
배당수익률(%)	4.4	3.5	2.2	2.0	7.7
EPS(원)	969	702	347	68	271
BPS(원)	5,385	5,813	5,881	5,877	6,042
SPS(원)	11,784	10,474	8,613	8,872	10,311
DPS(원)	250	200	75	75	280
수익성(%)					
ROE	19.3	12.4	5.9	1.2	4.5
ROA	15.4	9.5	3.9	0.6	2.6
ROIC	35.2	18.2	6.2	4.4	5.2
안정성(%)					
유동비율	318.0	199.3	157.7	161.5	164.4
부채비율	23.0	37.8	38.8	44.7	51.0
순차입금비율	-38.8	-19.7	-4.2	-2.9	-4.7
이자보상배율	583.7	22.1	2.5	1.5	2.1
활동성(%)					
총자산회전율	1.8	1.3	1.0	1.0	1.1
매출채권회전율	25.7	21.1	15.8	12.4	12.2
재고자산회전율	15.3	10.4	7.5	6.9	5.9

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
와이엠씨	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.10.20	와이엠씨-반도체로 넓히는 성장, 주주환원으로 높이는 가치
2023.04.20	와이엠씨-OLED 박사이클이 다가온다

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/ksirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소중한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '가치한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.